第二届中国 LED 照明论坛在上海隆重举行

2012 年 7 月 18-20 日，由中国照明电器协会主办的“2012 年中国 LED 照明论坛”在上海国际会议中心隆重举行。本届论坛共有来自生产企业、设计院所、工程公司的 550 余人参加。本届论坛的主题是“质量 效率 创新 发展”，会上总结了近年来 LED 照明应用方面的成果，研究了 LED 光源、灯具、驱动电源、智能控制等相关技术，探讨了 LED 照明相关标准，交流了 LED 照明产品设计、研发、生产工程实践等方面的经验，并展望了 LED 照明技术和应用的未来发展方向。发言结束后，论坛还进行了互动环节，与会者和台上专家就 LED 照明的价格成本、标准制定、设计创新、技术研发等广受关注的问题进行了交流。

中微公司在专利诉讼中再次获胜

中微公司在由美国泛林科技（LAM）于台湾针对中微公司及其关联公司发起的专利诉讼中再次获胜。台湾最高级法院分别做出以下两项判决：

第一项判决涉及泛林科技指控中微公司侵犯其第 I36706 号台湾专利（“电浆密封环专利”）。此前，台湾智慧财产法院针对该项指控已做出有利于中微的判决，泛林科技因不服而再次提起上诉；2012 年 7 月 11 日，台湾最高法院做出终审且不可上诉的判决，驳回了泛林科技的二次上诉。

第二项判决结束了关于另一项专利——第 126873 号台湾专利（“聚焦环装置专利”）的侵权争端。此前台湾智慧财产局曾做出判决认定泛林科技的该项专利为无效专利，泛林科技不服该判决再次提起上诉；2012 年 6 月 21 日，台湾最高行政法院驳回了泛林科技提起的上诉，维持原判。并认同中微公司原先的主张，认定该专利因缺乏新颖性和创造性而无效。因此，泛林科技控告中微专利侵权的基础不成立。此判决为终审判决，不可再上诉。

台积 20 纳米 8 月试产

晶圆代工龙头台积电的 20 纳米制程预计将于 8 月试产，成为全球首家导入 20 纳米的半导体厂。若试产成功，将超越英特尔先前以 22 纳米制程生产自家处理器芯片，大幅拉开与韩国三星电子的差距，在全球晶圆代工业取得绝对优势。

根据设备商透露，鉴于英特尔、三星加快跨足晶圆代工脚步，台积电原计划于今年 6 月提前试产 20 纳米制程，但因 20 纳米制程是 28 纳米延伸，在 28 纳米良率未达预期进展，客户又疯狂排队抢产能，台积电决定先提升 28 纳米制程良率以满足客户需求，将 20 纳米制程进度延后。另外，台积电近期除启动 28 纳米制程产能布建计划，同时通知设备商于 8 月开始准备试产 20 纳米制程，必须做好相关试产有关材料准备，代表台积电在 28 纳米制程良率大幅提升。

另据消息人士表示，由于 20 纳米也是台积电承接苹果新一代处理器的利器，随着台积电决定 8 月试产 20 纳米制程，也预示着台积电的苹果处理器订单已入袋。如果试产成功，台积电将以极快的速度布建产能，进度不仅领先英特尔，更将韩国三星追赶时间拉长至少 1 年以上。

KLA-Tencor 安装首个能够处理 450mm 硅片的 Surfscan® SP3 系统

KLA-Tencor 公司宣布其第一台能够检测 450mm 硅片的半导体制程控制系统已装机。该系统被命名为 Surfscan SP3 450，是市场领先的 Surfscan® SP3 平台的最新配置。这种全自动化的无图案硅片检测系统是为满足 20nm 及以下制程缺陷与表面品质特性的严格要求而专门设计的。该系统除了可以用于对 450mm 抛光基板和外延硅基板生产工艺的控制外，还可以为 450mm 工艺设备的生产商如湿清洗设备、化学机械抛光 (CMP) 垫、研磨液和抛光机、薄膜沉积设备和退火设备提供所需的检测能力。

新的 Surfscan SP3 450 检测系统可以帮助表征硅片的表面缺陷与质量，测量薄膜厚度和表面粗糙度均匀性，甚至甄别退火问题。SP3 450 是业界向 450mm 过渡的一个关键工具。

SP3 是业界唯一采用深紫外线 (DUV) 光照的高灵敏度无图案晶圆检测系统，并且是同类工具中唯一能够生成高分辨率图像的表面质量检测产品。Surfscan SP3 450 的另一项优势是其光学系统可靠性和算法已在 50 多台安装于全球先进开发与生产部门的 300mm SP3 平台上得以证明。

Surfscan SP3 450 系统现已收到多笔来自业界领先的芯片厂商、基板与工艺设备生产商以及一个纳米电子研究中心的订单。Surfscan SP3 还提供单一 300mm 操作版本和 300mm/450mm 共用结构。